

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站就本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市刊發的《華虹半導體有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心（董事長）

唐均君（總裁）

非執行董事：

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚

华虹半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1228号文同意注册。《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、国开证券股份有限公司

的住所，供公众查阅。

| 本次发行基本情况 | | | |
|----------------------|--|------|----------------|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 无面值 | | |
| 发行股数 | 本次公开发行股份 40,775.0000 万股，占本次发行后公司总股本的 23.76%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 | | |
| 本次发行价格（元/股） | 人民币 52.00 元/股 | | |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 不适用 | | |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | 联席保荐人子公司国泰君安证裕投资有限公司和海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，获配股数分别为 8,155,000 股，获配股数对应金额分别为 424,060,000.00 元，最终跟投比例分别为 2%。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 | | |
| 发行前每股收益 | 1.96 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算） | | |
| 发行后每股收益 | 1.50 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算） | | |
| 发行市盈率 | 34.71 倍 | | |
| 发行市净率 | 2.19 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） | | |
| 发行前每股净资产 | 15.17 元（按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算） | | |
| 发行后每股净资产 | 23.76 元（按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 | | |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额（万元） | 2,120,300.00 万元 | | |
| 发行费用（含税） | 28,232.30 万元 | | |
| 发行人和联席主承销商 | | | |
| 发行人 | 华虹半导体有限公司 | | |
| 联系人 | 董事会办公室 | 联系方式 | 86-21-38829909 |

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| 联席保荐人（联席主承销商） | 国泰君安证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系方式 | 021-38676888 |
| 联席保荐人（联席主承销商） | 海通证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系方式 | 021-23187958 |
| 联席主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系方式 | 010-60838692 |
| 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系方式 | 010-65051986 |
| 联席主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 | | |
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系方式 | 021-23153864 |
| 联席主承销商 | 国开证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场组 | 联系方式 | 010-88300198 |

发行人：华虹半导体有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年7月31日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023年 7 月 31 日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 7 月 31 日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年 7 月 31 日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年7月31日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023 年 7 月 31 日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023年7月31日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年 7 月 31 日

